

微晶玻璃加熱器開發技術

蔡博章, 鄧崑堂

機械工程學系

工學院

bjtsai@chu.edu.tw

摘要

展新的工業技術隨著科技產業急速發展，及科技材料之應用，可說是一日千里，因此新產品設計開發，講求輕、薄、短、小的目標，快速開發出輕便型電子、通訊、電腦、家電產品的驅勢下發展。微晶玻璃高溫加熱器將順應此發展方向進行開發研究。此研發產品之外型尺寸380x280x35mm為薄型勘入式設計，另外電磁波輻射在0.2毫高斯以下、耗電量110V/1400W規格要求，同時須經過電磁干擾、衝擊、鍍膜厚度、附着力、熱分佈量測、電力消耗、鍍層結晶等檢試。在電熱鍍膜製程技術及熱薄膜精密量測分析技術，是近年來半導體元件及電子、通訊電腦、家電產品、精密模具等，提昇表面處理所不可欠缺的技術。電熱鍍膜製程技術可增加原材料所沒有的物理特性之外，同時可以強化材料表面的組織，以達到耐腐蝕和耐高溫耐磨耗等優點，對日後特殊環境要求之產品後處理加工有很大的發展潛力。

關鍵字：微晶玻璃,